

2021年3月期 第1四半期（2020年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2020年7月28日

内容：

- 第1四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第1四半期 連結決算の概要

2020年7月28日

布川 好一

取締役 専務執行役員 ファイナンス本部長



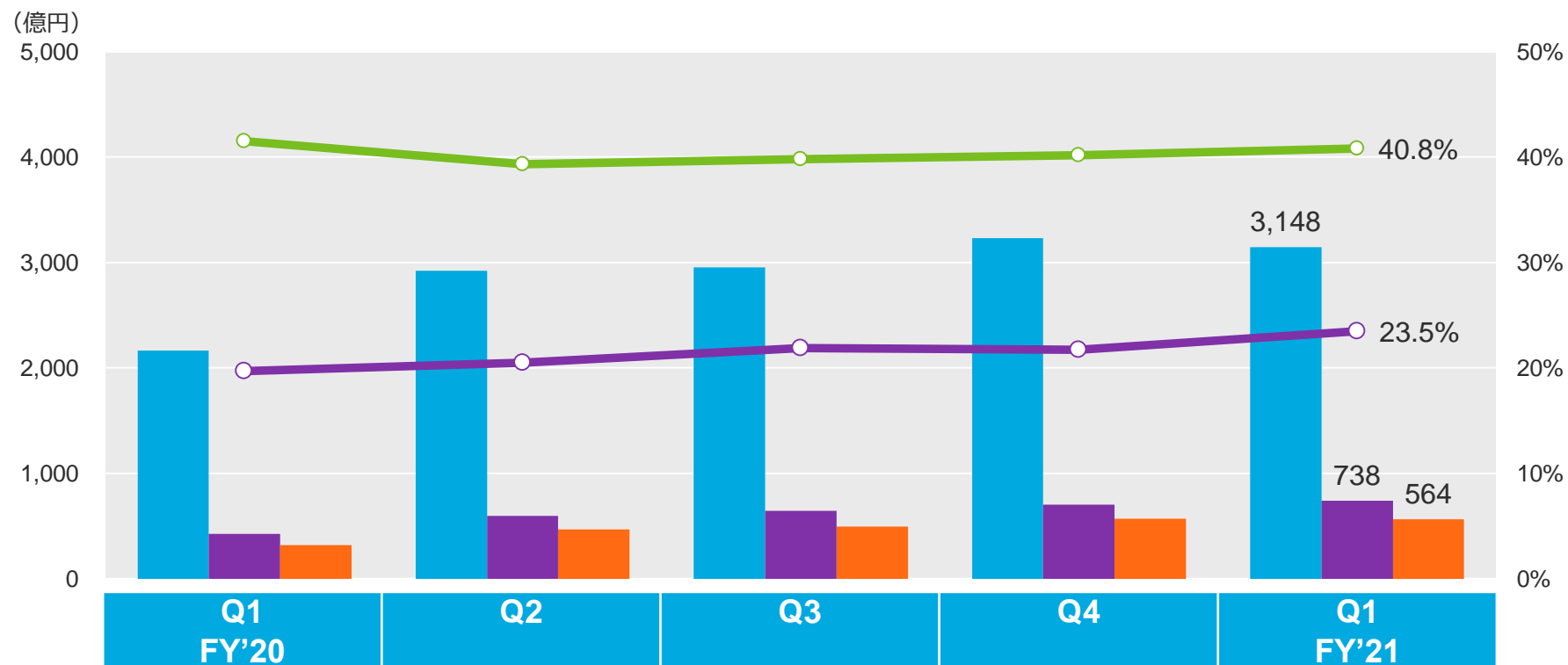
損益状況

(億円)

	FY2020				FY2021	対FY2020 Q4 増減
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
売上高	2,164	2,920	2,954	3,233	3,148	-2.6%
SPE	1,981	2,718	2,820	3,089	3,037	-1.7%
FPD	182	201	133	143	110	-23.4%
売上総利益	898	1,146	1,175	1,298	1,284	-1.1%
下段：売上総利益率	41.5%	39.3%	39.8%	40.2%	40.8%	+0.6pts
販管費	473	547	528	597	546	-8.5%
営業利益	425	599	647	701	738	+5.3%
下段：営業利益率	19.7%	20.5%	21.9%	21.7%	23.5%	+1.8pts
税金等調整前当期純利益	445	620	646	733	746	+1.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	318	468	493	571	564	-1.2%
研究開発費	256	312	298	334	301	-10.0%
設備投資額	76	220	132	117	132	+12.6%
減価償却費	60	67	76	86	71	-16.9%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況

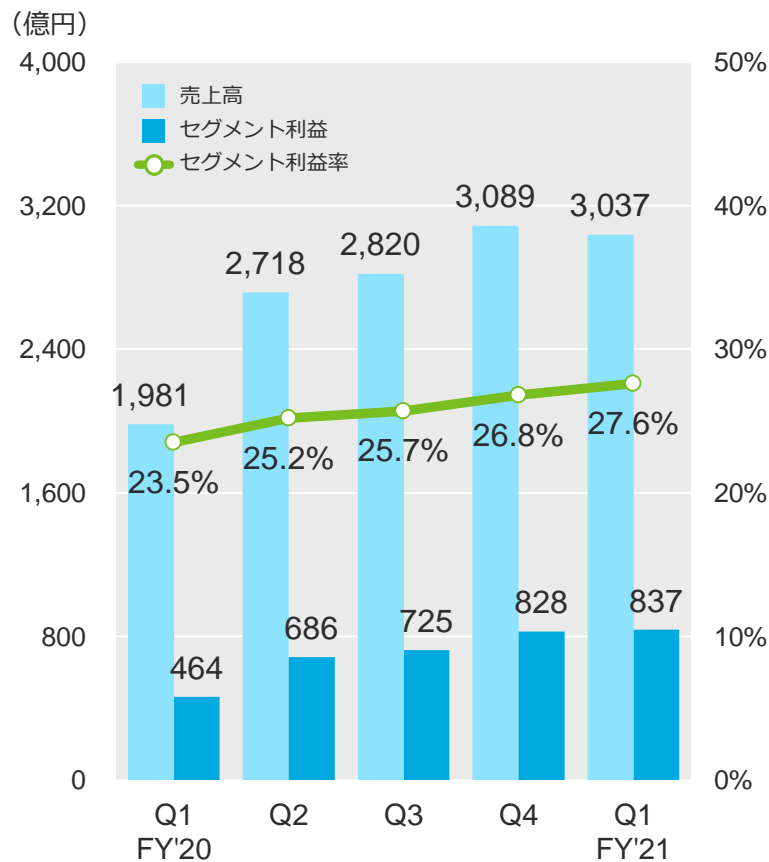


売上高	2,164	2,920	2,954	3,233	3,148
営業利益	425	599	647	701	738
親会社株主に帰属する 当期純利益	318	468	493	571	564
売上総利益率	41.5%	39.3%	39.8%	40.2%	40.8%
営業利益率	19.7%	20.5%	21.9%	21.7%	23.5%

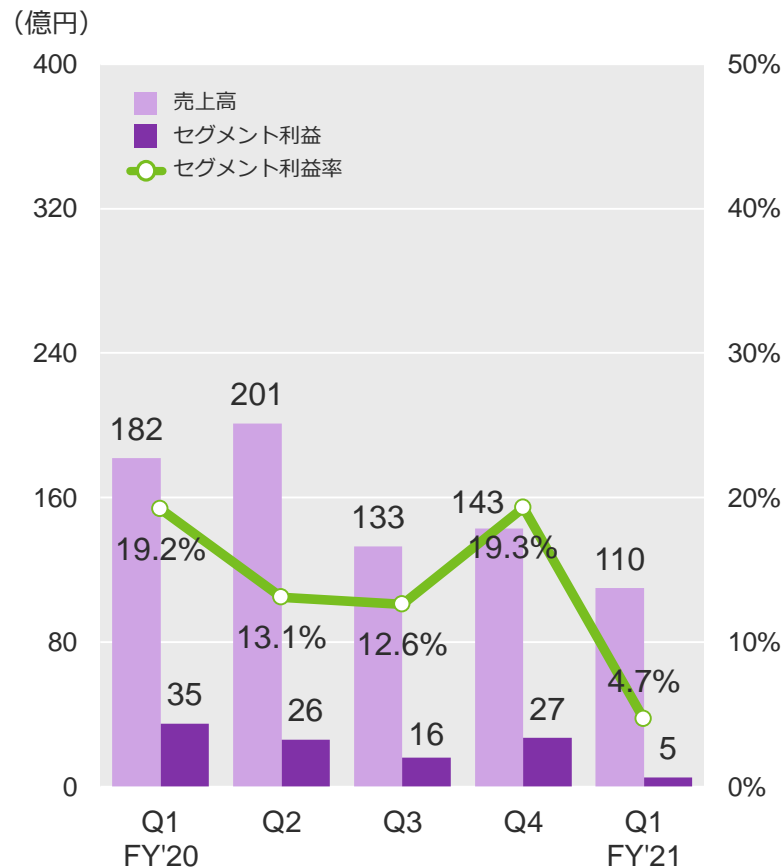
Q1業績は上期計画に沿って順調に進捗

セグメント情報

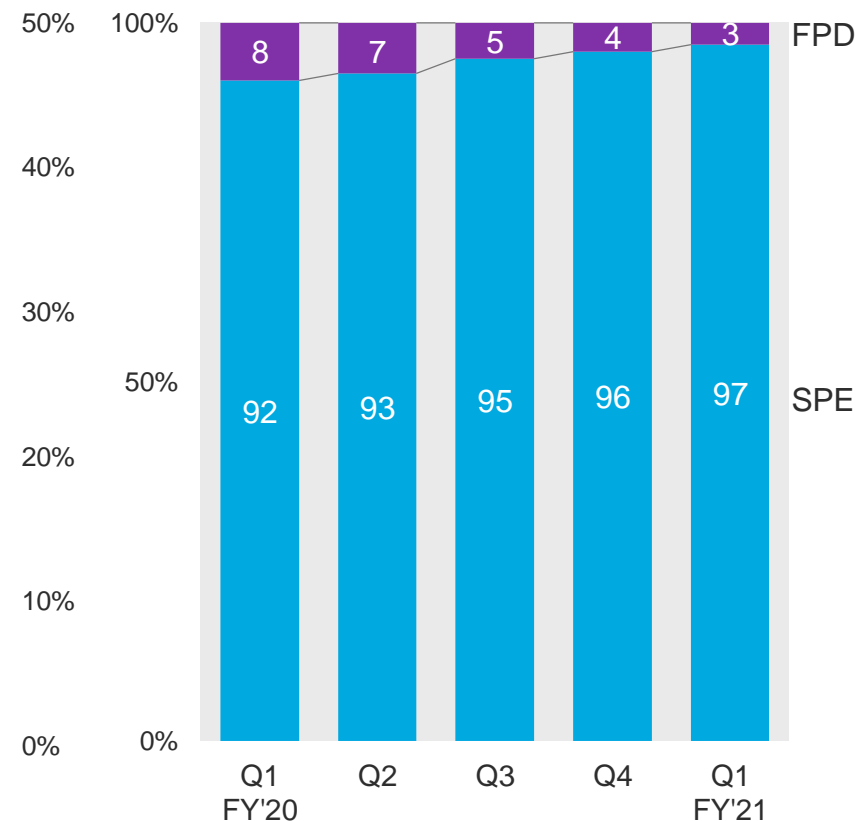
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



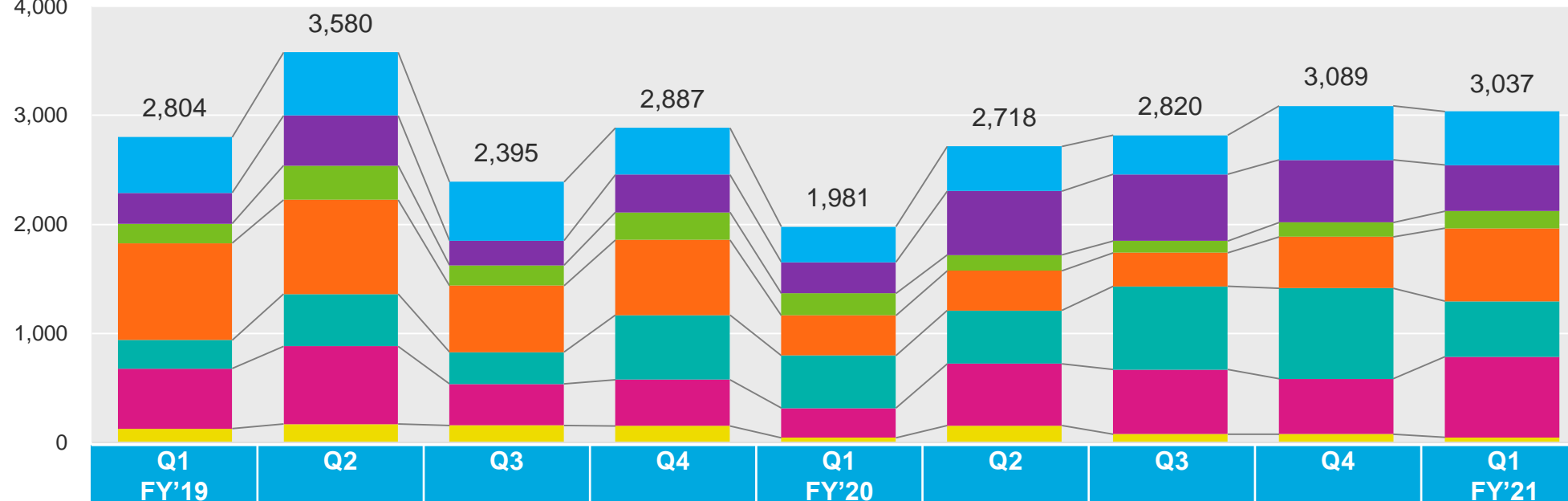
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

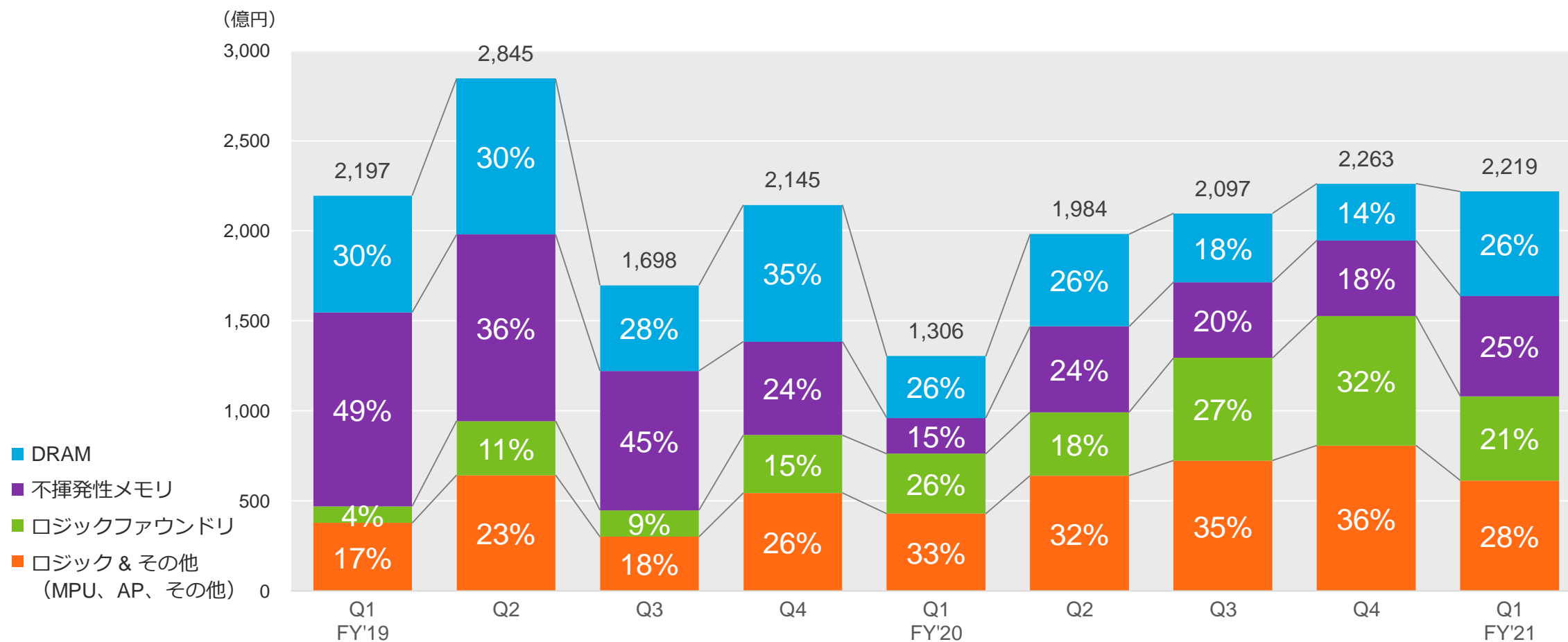
SPE部門 地域別売上高

(億円)
4,000



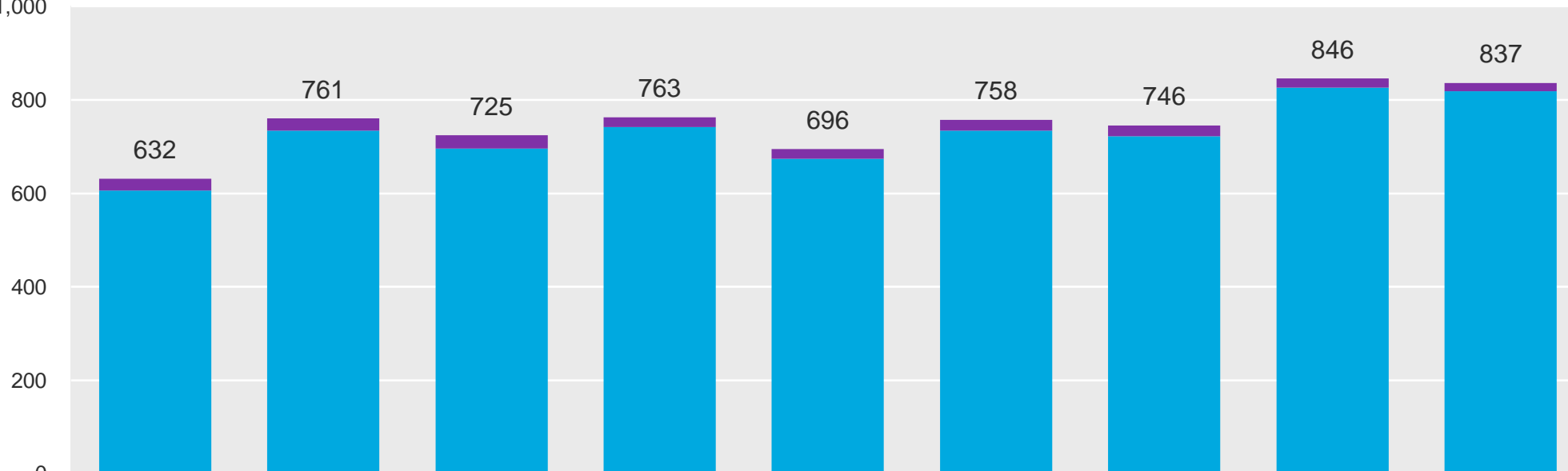
■ 日本	511	580	540	427	325	410	359	496	491
■ 北米	284	459	227	347	285	588	610	572	423
■ 欧州	177	313	186	253	202	144	108	133	157
■ 韓国	889	865	609	689	369	364	310	471	670
■ 台湾	263	480	293	591	483	487	762	831	509
■ 中国	549	713	380	425	270	568	591	506	739
■ 東南アジア・他	127	168	156	152	44	155	77	77	46

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



フィールドソリューション売上高

(億円)
1,000

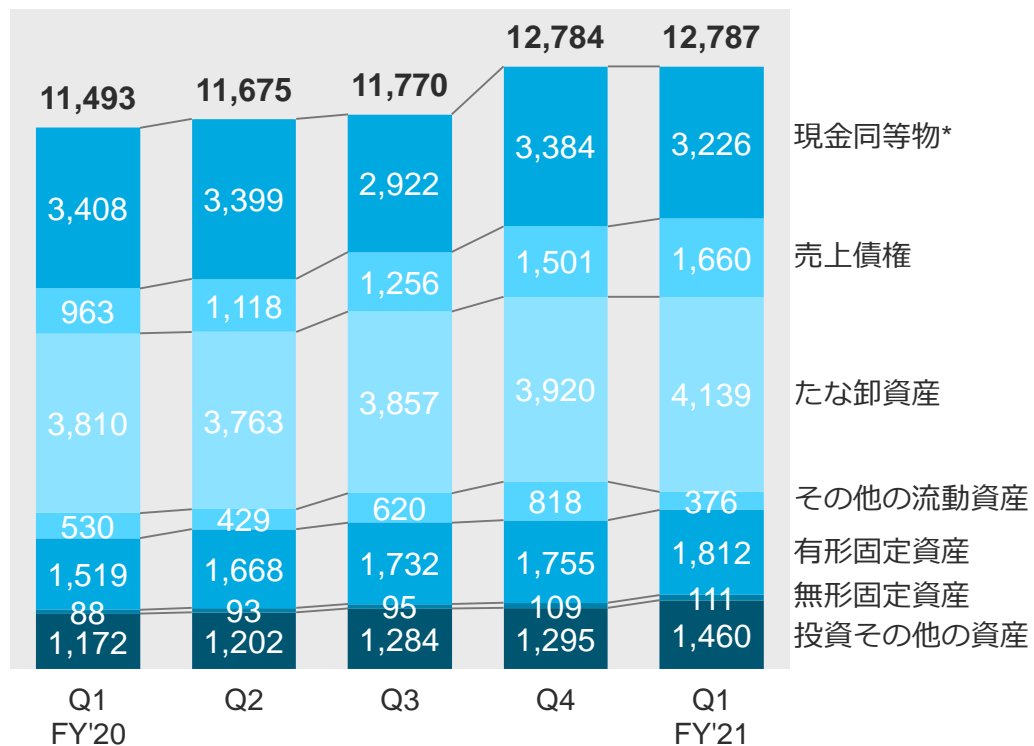


	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'21
SPE売上高	606	734	696	742	674	734	722	826	818
FPD売上高	25	27	28	21	21	23	23	20	18

貸借対照表

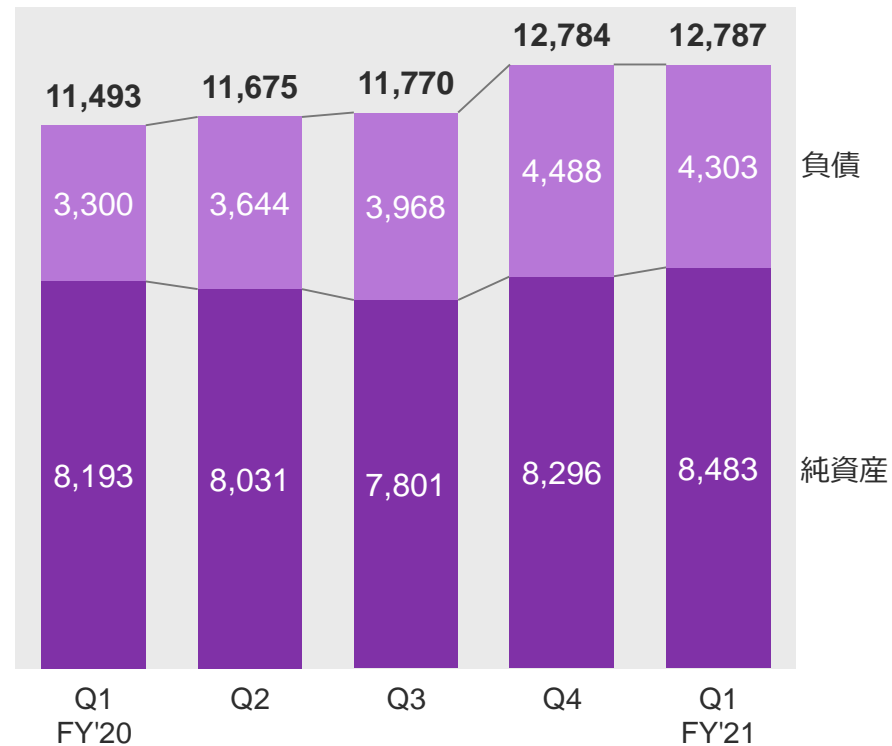
資産

(億円)

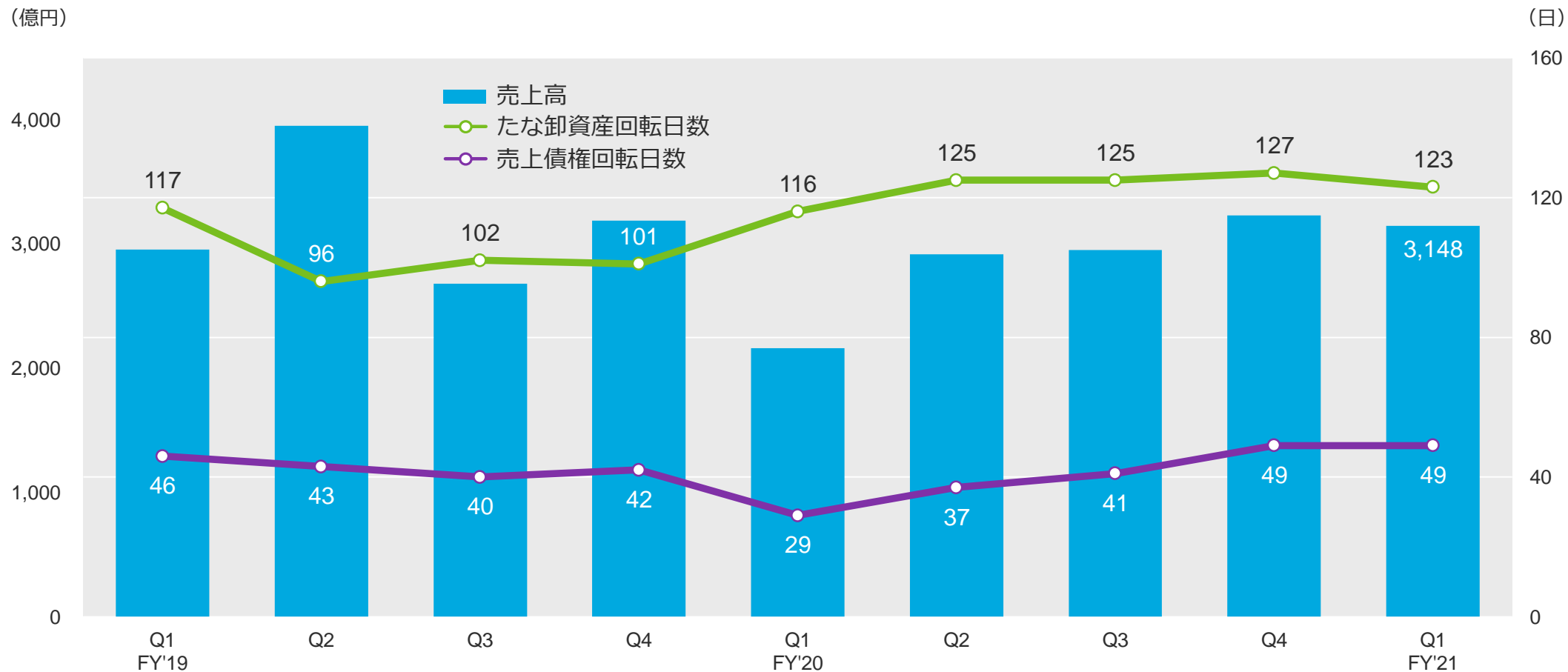


負債・純資産

(億円)

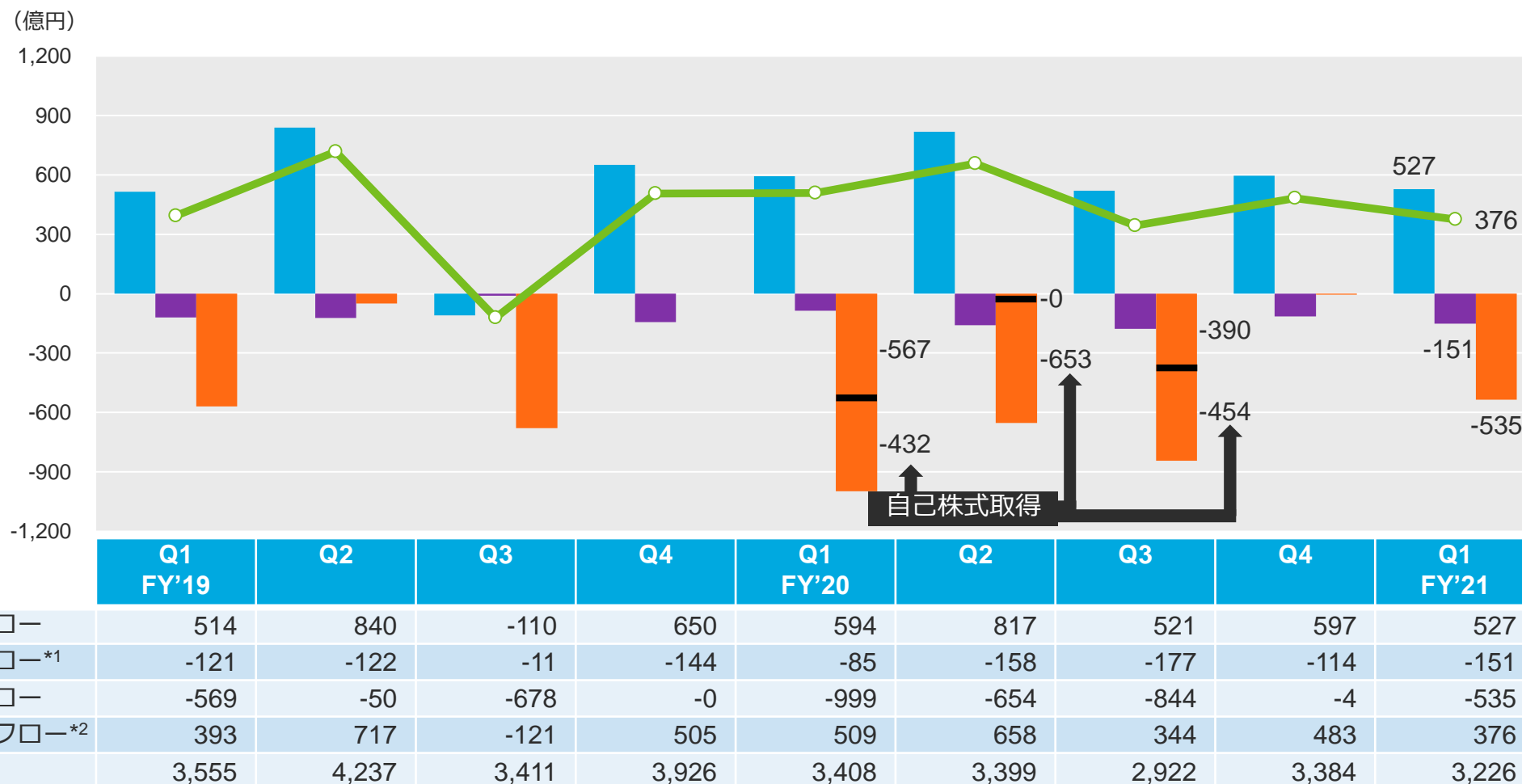


たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー



*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

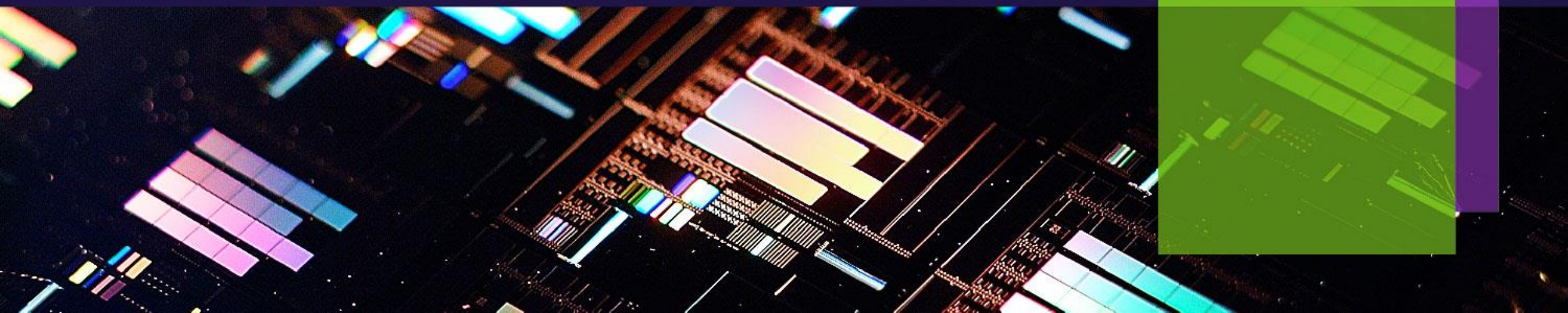
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2020年7月28日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2020年7月時点での見方）

- ▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資
CY2020の投資は、前年比10%程度の増加を想定
マクロ経済の動向に注視は必要だが、足元の引き合いは堅調
過去最高のWFE市場規模になると予測
- ▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資
TV向け大型パネル投資は継続。モバイル向けOLED投資が回復
CY2020は前年比15%程度の成長を期待

事業環境の見通しについて、前回発表（2020/6/18）から変更なし

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

FY2021 事業進捗 (Q1)

- Q1事業活動は計画に対して順調に進捗
 - 工場稼働：調達・生産・出荷は計画通り
 - 装置設置：現地従業員・駐在者および一部リモートサポートにより継続
 - フィールドソリューション：顧客工場の高い稼働率を背景に、通期計画に対して順調に進捗

FY2021 事業機会と注力分野

■ ロジック/ファウンドリ

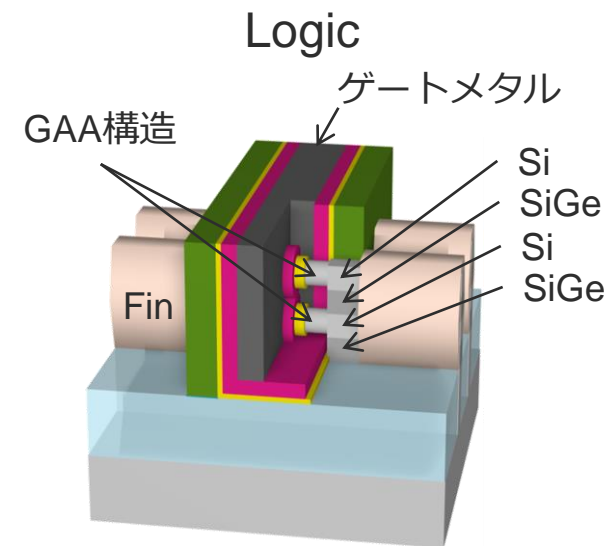
- EUV：新材料レジスト向け塗布・現像とエッチング
- コンタクト：高選択エッチング、低抵抗メタル成膜
- GAA*1：新規プロセス（Si/SiGe Finエッチング、等方性選択エッチング、微細三次元構造の洗浄）

■ DRAM

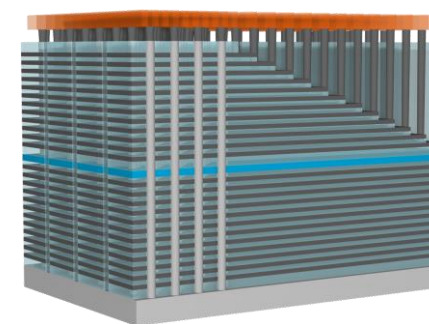
- パターニング：微細化に対応したソリューション提案
- キャパシタモジュール：微細深穴エッチング・電極成膜・パターン倒壊抑制ウェットエッチング・高誘電率材料成膜

■ 3D NAND

- 高アスペクト比：200層以降に向けたエッチングの加工性能と生産性の向上、ALD/CVDを使った埋め込み成膜
- RGM*2：犠牲膜高選択ウェットエッチング、新材料成膜



3D NAND



FY2021 業績予想

FY2021 業績予想 (2020/6/18発表から変更なし)

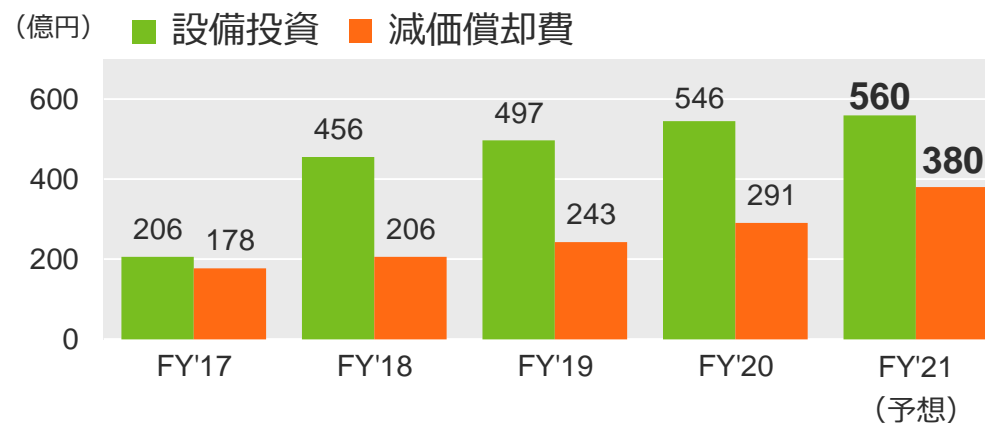
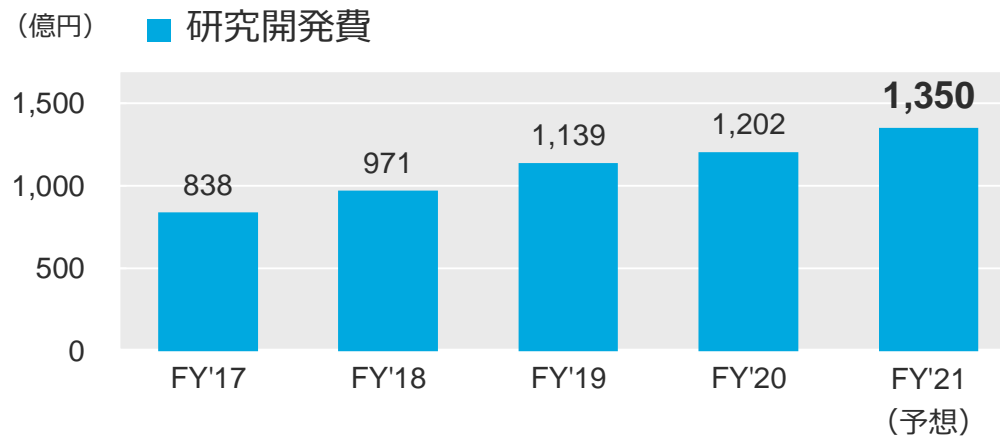
(億円)

	FY2020 (実績)	FY2021 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	11,272	6,200	6,600	12,800	+13.5%
SPE	10,609	5,850	6,150	12,000	+13.1%
FPD	660	350	450	800	+21.0%
売上総利益	4,519	2,480	2,720	5,200	+679
下段：売上総利益率	40.1%	40.0%	41.2%	40.6%	+0.5pts
販管費	2,146	1,210	1,240	2,450	+303
営業利益	2,372	1,270	1,480	2,750	+376
下段：営業利益率	21.0%	20.5%	22.4%	21.5%	+0.5pts
税金等調整前当期純利益	2,446	1,270	1,480	2,750	+303
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,852	950	1,100	2,050	+197
1株当たり当期純利益 (円)	1,170.57	610.83	-	1,318.10	+147.53

成長投資を継続しつつ、売上高と利益の増加を目指す

FY2021 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,350億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 380億円



新生産棟の建設

(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



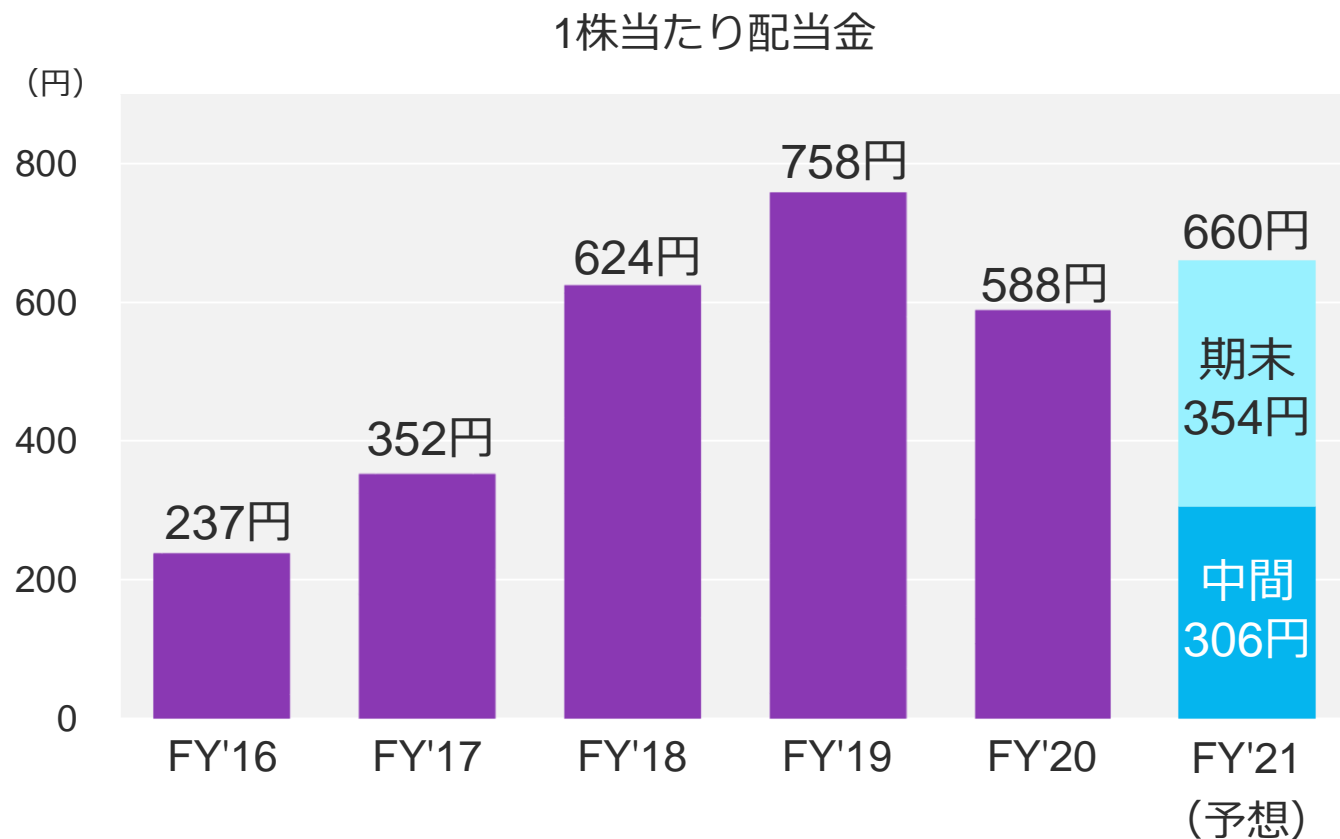
山梨県富士吉野市：建設費約130億円
(2020年8月 稼動開始予定)



岩手県奥州市：建設費約130億円
(2020年7月 稼動開始)

将来の成長ポテンシャルを最大限取り込むため、
過去最高の研究開発投資を見込む

FY2021 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、配当性向 50%に沿って 660円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON